



检测报告

样品名称：集成电路

型号规格：XCKU060-2FFVA1156I

器件品牌：XILINX

委托单位：

深圳市创芯在线检测服务有限公司

2024 年 10 月 15 日



检测 报 告

公司：

地址：

样品名称：集成电路

型号：XCKU060-2FFVA1156I

器件品牌：XILINX

批次代码：2317

器件封装：BGA-1156

样品数量：100 片

检测数量：100 片

收样日期：2024/10/09

测试日期：2024/10/15/11: 00 - 2024/10/15/13: 45

报告专用章

检 测 _____

审 核 _____

批 准 _____

测试项目

- ☐ 外观检查
- ☐ 电特性测试
- ☒ 编程烧录
- ☐ 可焊性测试
- ☐ X-ray 检测
- ☐ XRF 测试
- ☐ 关键功能测试
- ☐ 烘烤
- ☐ 编带
- ☐ 丙酮测试
- ☐ 开盖测试
- ☐ SAT 检测
- ☐ 切片测试

测试方法及测试设备

1.1 测试标准：

- **AS6081A-2023**

1.2 显微镜：

- 设备规格：

光学显微镜：SEZ-260 X7-X45 (校准有效期至：2025/07/17)

1.3 功能测试设备：

- 设备规格：

数模混合信号测试机：TR6850 (校准有效期至：2025/07/17)

1.4 检测依据：

- 《XILINX XCKU060-2FFVA1156I》：

<https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds890-ultrascale-overview>



测试 结 果

编程测试结果：

编程测试	结果：
测试总量	100 片
通过数量	0 片
失败数量	100 片
注	所有样品通过JTAG检测、ID检测以及编程测试， EFUSE控制寄存器已被加密，失败。
编程测试结果	
编程测试	结果
JTAG配置检测	通过
编程检测	通过
ID检测	通过
读取EFUSE寄存器	失败

1. 芯片描述：

UltraScale™架构包括高性能FPGA、MPSoC和RFSoc系列，可满足广泛的系统需求，重点是通过创新技术进步降低总功耗。

2. 封装尺寸：

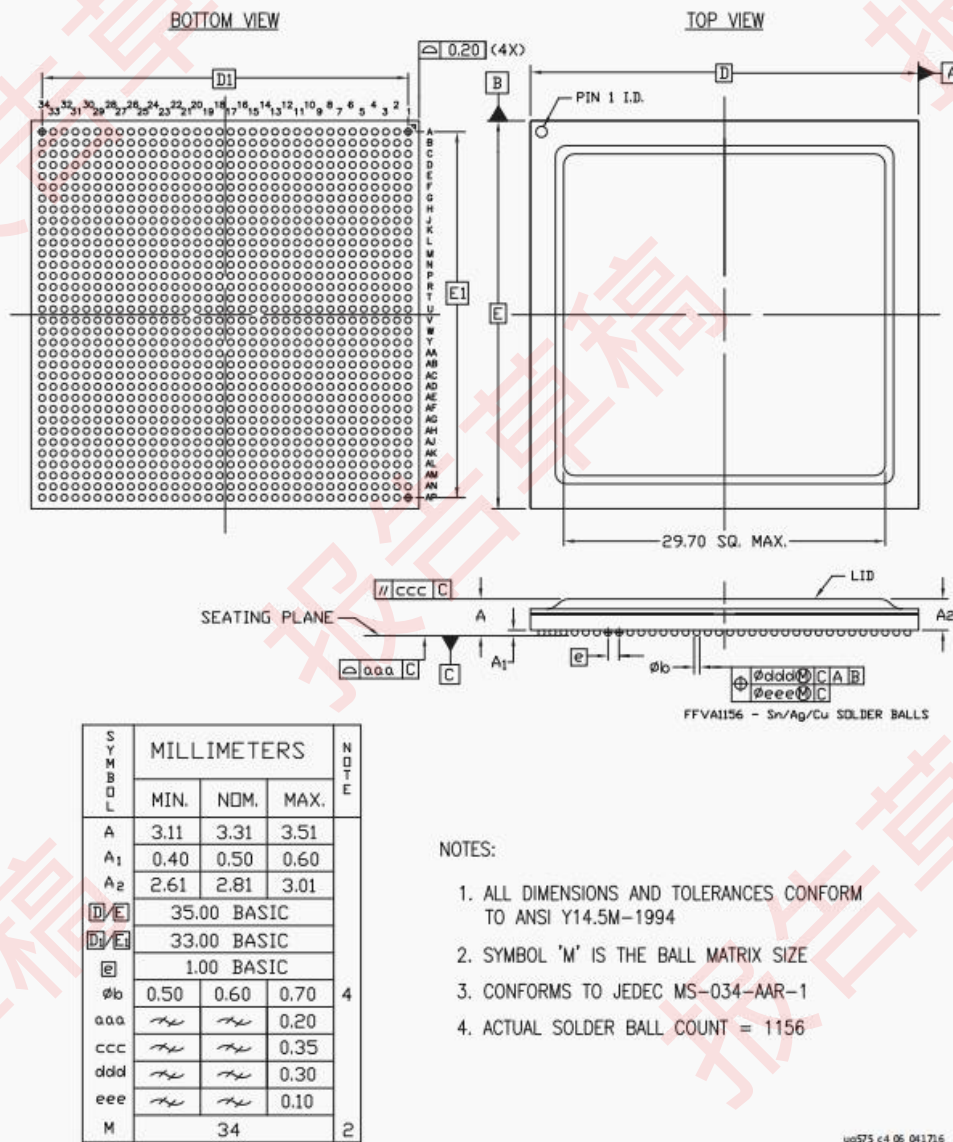


Figure 4-15: Package Dimensions for FFVA1156 (XCKU060, XCKU095, and XCKU11P)

重量	1869 g	来料数量	100片
箱子数量	N/A	完整标签	N/A
封装类型	托盘	防潮保护	N/A
MSL等级	N/A	ESD保护	N/A

备注：客户提供测试样品 100 片。



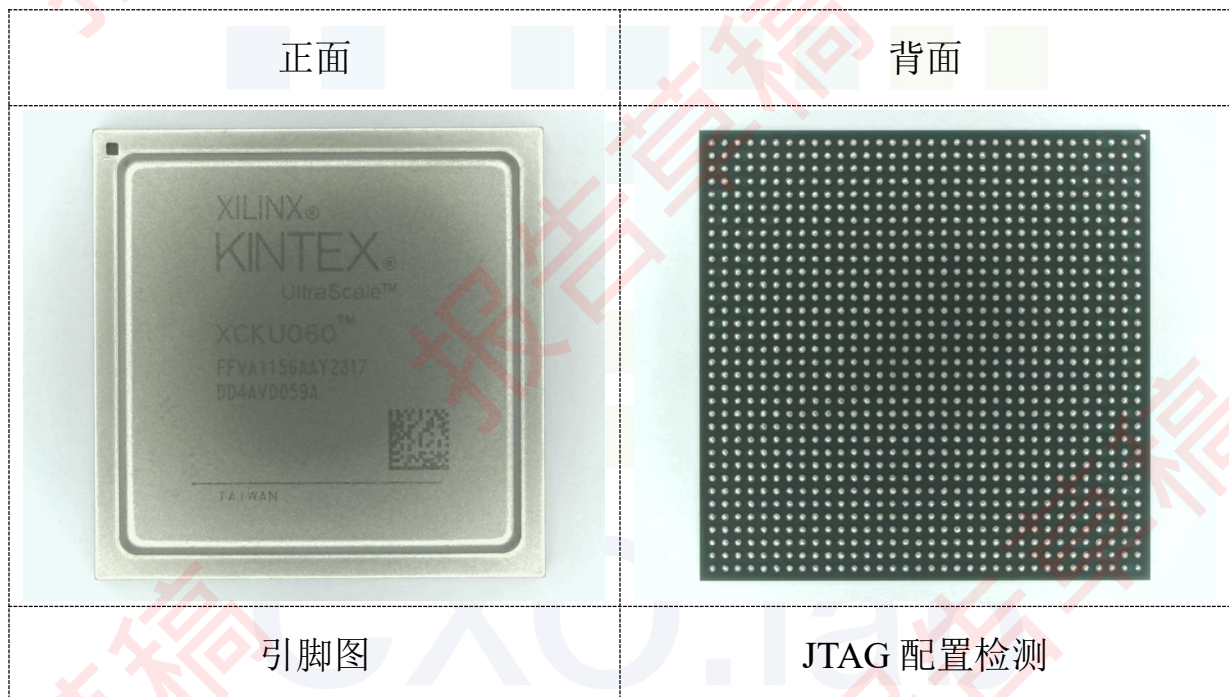
4. 编程测试：

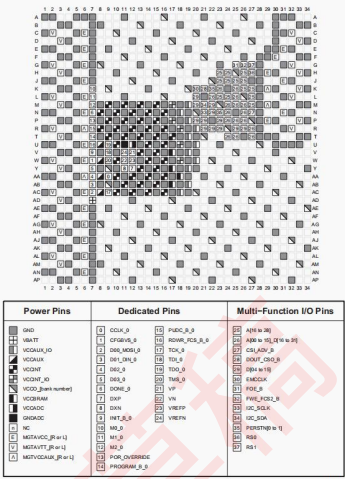
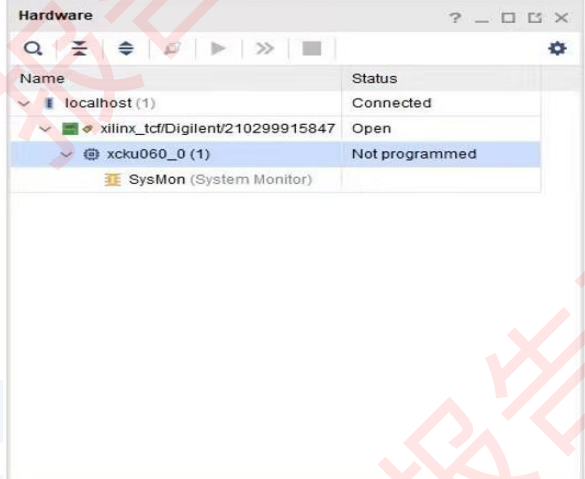
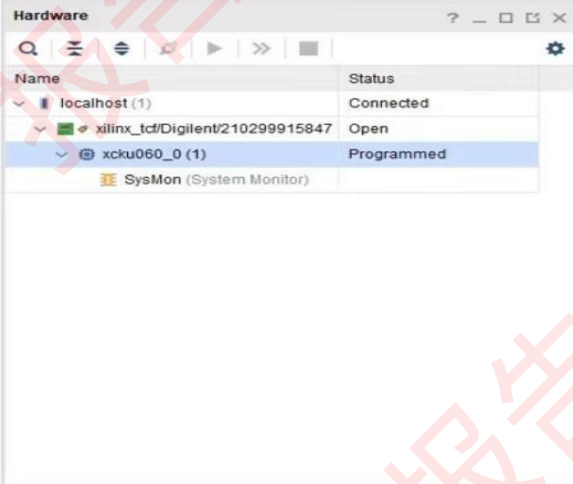
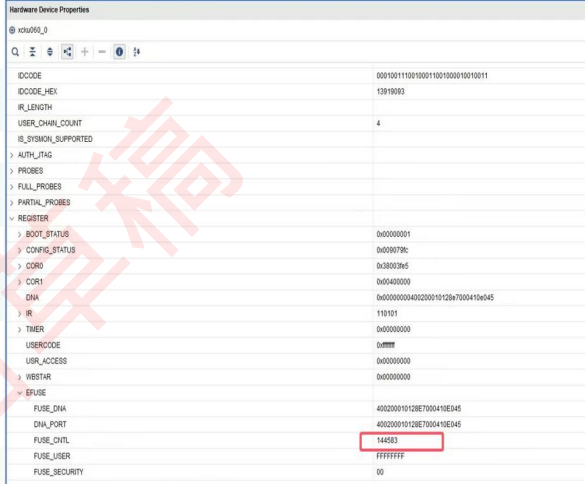
依据标准：**AS6081A-2023**

环境温度：24.4 °C 相对湿度：59.8 % RH

客户提供制造商为 **XILINX** 型号 **XCKU060-2FFVA1156I** 的 100 片样品使用 Vivado 2023.1 软件对芯片进行了以下测试：

- JTAG 配置检测
- 编程检测
- ID 检测
- 读取 EFUSE 寄存器



	
ID 检测 & 编程测试通过	EFUSE 控制寄存器（已被加密）
	

编程测试	结果:
测试总量	100 片
通过数量	0 片
失败数量	100 片
注	此样品通过JTAG检测、ID检测以及编程测试，EFUSE控制寄存器已被加密，失败。

-报告结束-

声 明

1. 检测报告无“公司章”及“骑缝章”无效。
2. 复制检测报告未重新加盖“公司章”及“骑缝章”无效。
3. 检测报告中无检测、审核、批准人签字视为无效。
4. 检测报告涂改、部分提供和部分复制无效。
5. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 检测报告仅对收样检测结果负责，不对批量产品质量负责。
7. 加*者为分包检测数据。



CXO 实验室公众微信号

电话：0755-83762185

邮箱：engineer@iclabcn.com

网站：https://www.iclabcn.com

地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路393号英达丰工业园A栋2楼